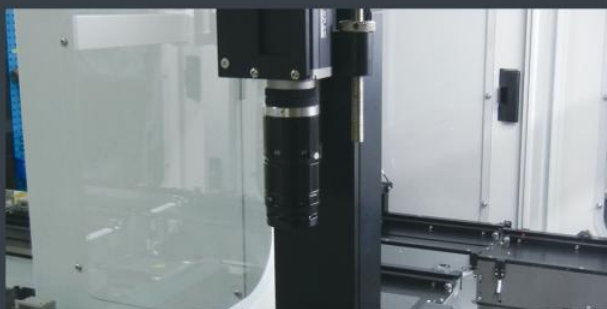


P/P system



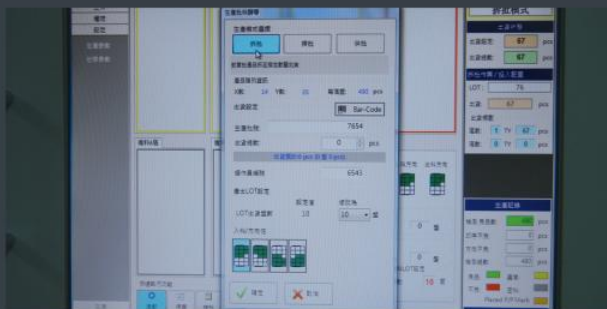
CCD inspection



Vacuum suction



Handler operating interface



Inspection operating interface



CLASSIFICATION SYSTEM CF-S750

全自動Jedec Tray拆/併批系統

搭載CCD印字檢查系統，可避免混料與印字品質異常。支援多樣產出模式（掃批、併批、拆批），可依產線需要選擇使用。

- Auto Load & Unload：可裝載 25 個Tray，並可在動態中補料。
- 具掃批 / 拆批 / 併批 3 種操作模式。
- 掃批可檢查整體產品品質；拆批除品質控管，亦可控制出貨數量；併批則為多小批之數量與總數管制出貨。
- CCD檢測採 Vitrox® 視覺系統，進料區做基本印字檢查，出料區則除方向檢查外，另具備基本 Lead 檢查機制。
- CCD光源系統可共用於 INK / Laser Mark。
- 餘料良品排列後，比照正常出料，並傳送至專屬出料區域。
- 具備 Bar-Code操作能力，並可按客戶需求輸入介面。
- 高速 P/P 取料系統：3 吸嘴自動調整機構，可進行補料/排序作業。
- 免改機設計：僅需變更工作檔案即可生產，無需改機*。

*免改機是指更換作業時無須變更重大硬體，但不包括因變更產品尺寸時之吸嘴更換。



| Items | Specification Descriptions |
|-------------------------------|---|
| Machine Dimension | 2160(W) x 1490(D) x 2150(H) mm |
| Machine Weight | 1200 kg |
| U. P. H. | (Just One last tray in the LOT and NO units rejected or any abnormal system stop.) Scan/Split Mode: > 15K Merge Mode: > 10K *For above U.P.H. calculation not included operate preparation time. |
| Facility Consumption | 200~240V; 1ø3W; 50/60Hz; 25A |
| Air supply | 5 kgf/cm ² , AVG 30L/min |
| Conversion Time | < 10 mins |
| Application Tray Type | Standard JEDEC Tray |
| Application Package Type/Size | TSOP / QFP / QFN / BGA / CSP on 3x3 to 40x40 |